



RE966-01E

- Adaptador para QFP64
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para QFP64 con 0,80 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una fila 2,54 mm
- Diámetro de los agujeros 1,10 mm con nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- Dorso con almohadillas 0603 SMD en cada pin
- Resistencias o componentes similares pueden montarse directamente
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 46,99 x 46,99 mm